

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20190307

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	中再资产管理股份有限公司 王云翥 中庚基金管理有限公司 施展 国泰君安 陈飞达 招商证券 吴丹 合计 4 人
时间	2019 年 3 月 7 日
地点	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 宋天玺 证券事务代表 张娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、请董秘介绍下公司主营业务情况。</b></p> <p>公司主营业务为电子整机装联设备、光电模组生产专用设备的研发、生产、销售及服务。</p> <p>电子整机装联业务含电子焊接类设备和智能机器视觉检测设备。电子焊接类设备是公司成立以来一直在做的传统业务，主要包括波峰焊、回流焊、高温垂直固化炉及其他焊接设备，主要应用于 3C 产品 PCB 板的焊接。这块业务市场占有率约 30%，近年来销售一直保持了持续稳定增长。</p> <p>用于电子焊接类的智能机器视觉检测设备主要应用于焊接过程中的焊接良率检测，其中比较突出的产品是 AOI 检测设</p>

备和 3D-SPI 检测设备。该类 AOI 检测设备主要用于电子产品的生产中 PCB 上元件的装配品质检测及工艺品质控制,具备检测产品不良率并具备修复功能,能够用于 SMT 产线的焊前检测和焊后检测;3D-SPI 检测设备主要用于电子产品生产过程中对锡膏印刷质量及工艺,目前均已实现批量销售。光电模组业务主要是针对屏幕及配件设备,主要包括摄像头模组、生物识别模组、3D 玻璃、3D 贴合、显示屏模组等相关设备,其中摄像头模组生产设备主要涉及双摄及三摄技术的应用,已实现批量销售;屏下指纹模组设备也得到市场认可,实现销售收入。

## **二、公司 OLED 屏 3D 贴合设备最近的研究进展如何?是否签订订单?定价是多少?**

公司研制出的 3D 贴合设备样机,目前正在客户端进行验证,尚未签订正式订单。如果测试效果达到客户需求,公司将会参与该项目的投标。国外设备一条线可能达到 400-600 万美金,我们的设备报价要参考生产成本及配置,因现在还未实现量产及销售,具体价格尚不明确。

## **三、公司是如何切入这款 3D 贴合设备的?**

早几年,公司开始电容式指纹模组设备的研发生产,2017 年给客户提供了屏下指纹模组设备,奠定了一定的合作基础;加之公司之前研发过用于玻璃盖板与色彩薄膜之间贴合的 3D 贴合设备,而当前研发的 3D 贴合设备是用于柔性屏幕与玻璃盖板之间的贴合,相当于之前是做屏幕上层的贴合,现在是往中层贴合延伸,2017 年公司关注了此类设备,储备了一些技术。之前国内客户对此类设备基本从国外采购,但随着国外对该类设备禁运后,公司及国内的设备厂商在此领域迎来了机会。

**四、该款设备与普通 3D 贴合设备价值量上有多大区别？能否预测下该设备的毛利率？**

正如上一个问题提到的，这款 3D 贴合设备是用于柔性屏幕与玻璃盖板之间的贴合，屏幕的曲面弧度越大，贴合越难，所以相较普通贴合设备技术含量上更高一些，该款 3D 贴合设备是公司新研发产品，具有一定技术难度，按照往年惯例，新产品的毛利率会比传统业务的毛利率高一些。

**五、公司除了用于电子焊接类的检测设备，有没有考虑切入到面板检测？**

公司除了有应用于焊接过程中的 AOI 检测设备和 3D-SPI 检测设备，目前也在研发针对 OLED 屏检测的 Demura 自动外部补偿设备和针对盖板检测的 CG AOI 检测设备，这两款设备已研发出样机。

**六、公司的电子焊接业务未来会有怎样的布局？**

作为电子焊接行业的龙头企业，在电子焊接制造工艺上公司肯定会继续精益求精，此外随着环保要求的提高，减少环境污染也是作为上市公司的责任所在，所以公司会在努力维持传统业务的稳定增长的基础上，注重制造工艺以及环境保护方面的提升。

**七、公司电子焊接设备的技术革新周期是多久？未来公司电子焊接类业务还会继续增长吗？**

公司电子焊接设备的使用寿命是 10 年，技术革新的周期不到 10 年，但是从以往焊接 PCB 板的单层板到双层板再到多层板来看，每一代技术革新的周期相对较慢。目前来看，公司受益于多年经营累计的各项优势，电子焊接类业务仍是处于稳步增长阶段的，但具体增速主要取决于下游对 PCB 面板的需求和整个电子焊接行业的集中度情况。

	<p><b>八、公司电子焊接业务未来有没有可能被激光焊接替代？</b></p> <p>激光焊接主要适用于微小型零件的精密点焊，而公司的焊接设备可以实现元器件和 PCB 板之间的整体焊接，因而公司电子焊接和激光焊接在技术原理上是不一样的，不存在被替代的可能。</p> <p><b>九、请介绍下公司目前在产能、场地及人员等方面是否面临发展瓶颈？</b></p> <p>公司前几年因为场地原因，产能确实受限，公司新厂区已于去年底建成，新厂区建筑面积约是目前老厂区建筑面积的 3 倍，场地和产能方面的瓶颈将得到有效缓解。随着新厂区的建成，公司人力资源部已经在制定相应的招聘计划进行人员扩充。</p> <p><b>十、近期有公司董事在减持，是否还会继续减持？请介绍下具体情况。</b></p> <p>2018 年 10 月 20 日，公司披露了董事主逵先生的减持计划，其因个人资金需求，拟减持公司股份不超过 885,000 股。此后至 2019 年 3 月 5 日，其累计减持了 828,100 股。其减持计划的实施符合相关规定，后续公司会继续关注该事项的进展情况，各位可以关注后续公司披露的相关公告。</p>
附件清单（如有）	--
日期	2019 年 3 月 7 日